

ファインパターン対応

高耐食性無電解ニッケル／置換金めっきプロセス

ICPニコロンHFP／フラッシュゴールド330H

Electroless Nickel / Immersion Gold Plating Process for High Corrosion Resistance Applicable to Fine Patterning

ICP NICORON HFP / FLASH GOLD 330H

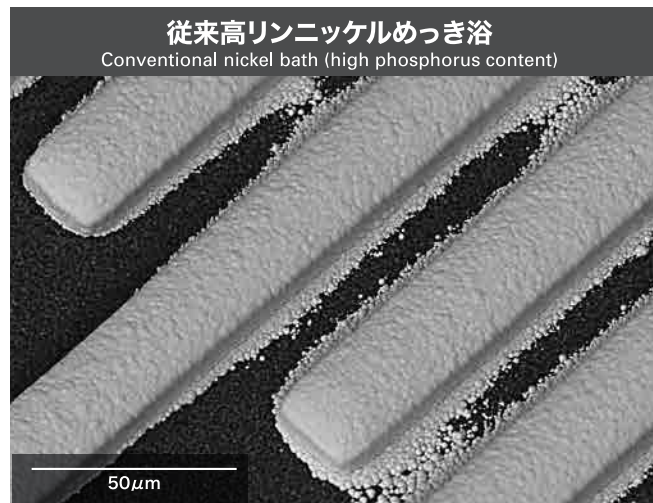
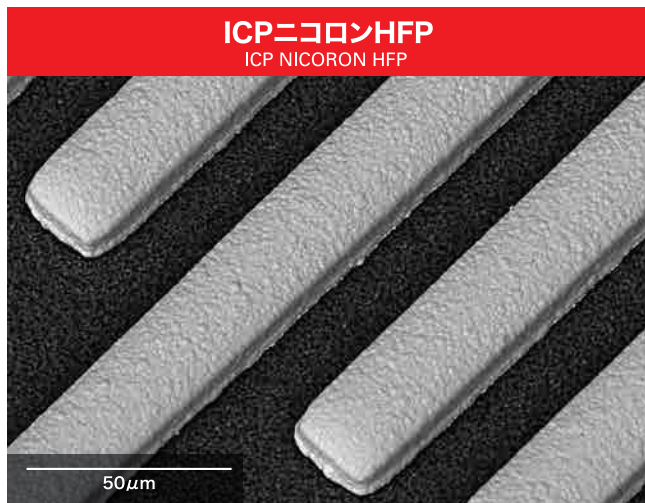
- ▶ ファインパターン性および耐食性に優れる
- ▶ はんだ濡れ性、はんだ接合強度が良好
- ・Excellent in fine pattern ability and corrosion-resistance
- ・Excellent in solder wettability and solder pull strength

優れたファインパターン性

Excellent in fine pattern ability

無電解ニッケルめっき:4 μ m L/S = 25/25 μ m

Electroless nickel plating:4 μ m L/S = 25/25 μ m



優れた耐食性

Excellent in corrosion resistance

無電解ニッケルめっき:4 μ m / 置換金めっき:0.05 μ m ⇒ 亜硫酸ガス腐食試験後、マイクロスコブ 観察

Electroless nickel plating :4 μ m / Immersion gold plating :0.05 μ m ⇒ Microscope image after SO₂ gas corrosion test

